

聯茂電子

2021年第三季營運成果

ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

February 2022

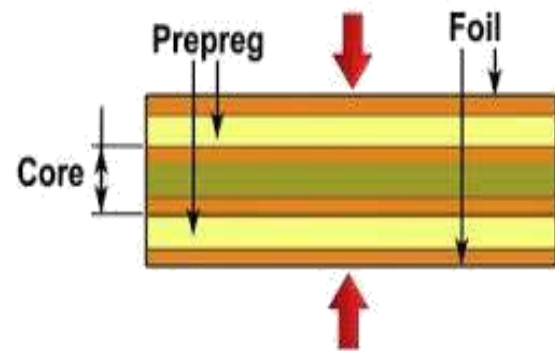
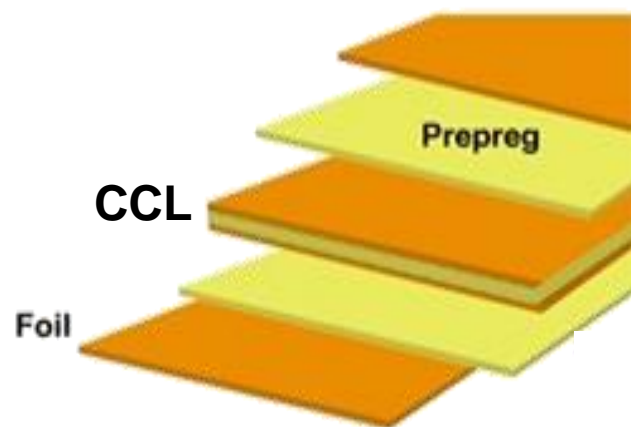
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新

公司簡介

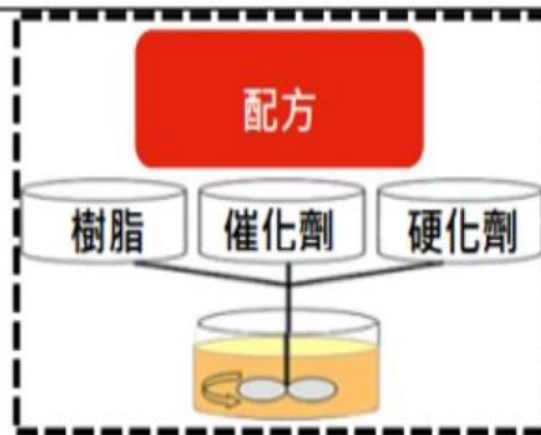
- ◆ 成立日期：1997年4月10日
- ◆ 總部地址：台灣省新竹縣新埔鎮大魯閣路17號
- ◆ 實收資本額：NT\$38.30億
- ◆ 員工人數：逾3,500人
- ◆ 董事長：陳進財 先生
- ◆ 執行長：蔡馨曄 女士
- ◆ 主要產品：
銅箔基板、膠片
軟性銅箔基板
多層壓合代工



CCL/PP



CCL 製程圖



玻纖布



銅箔基板

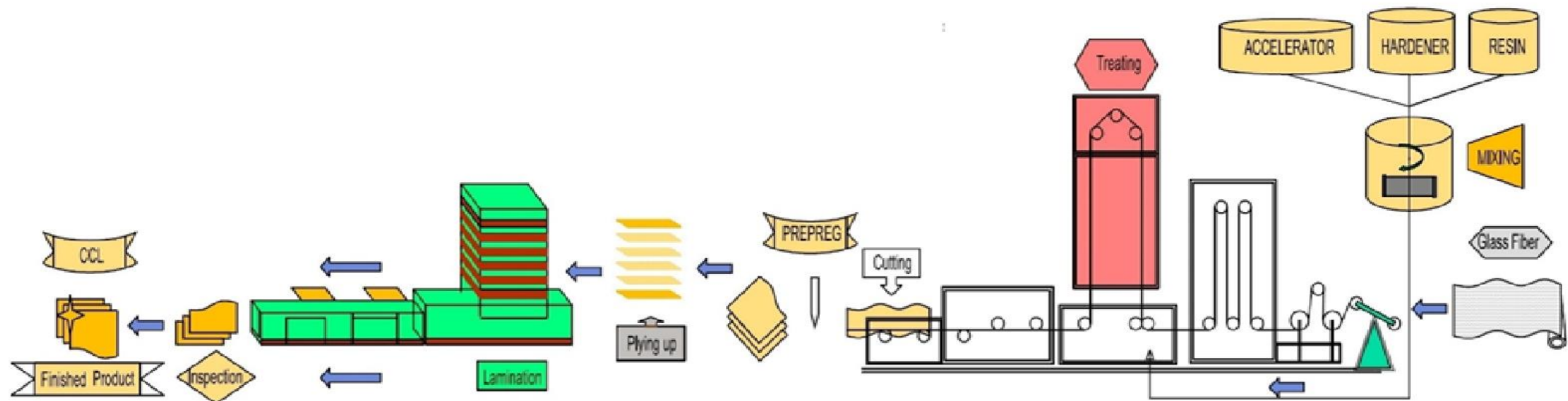
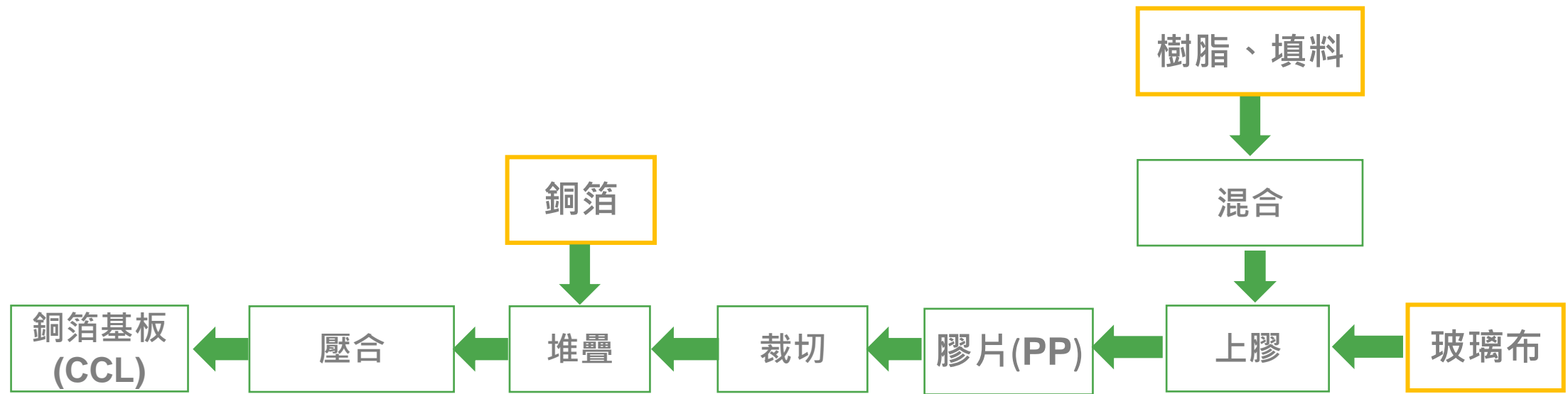


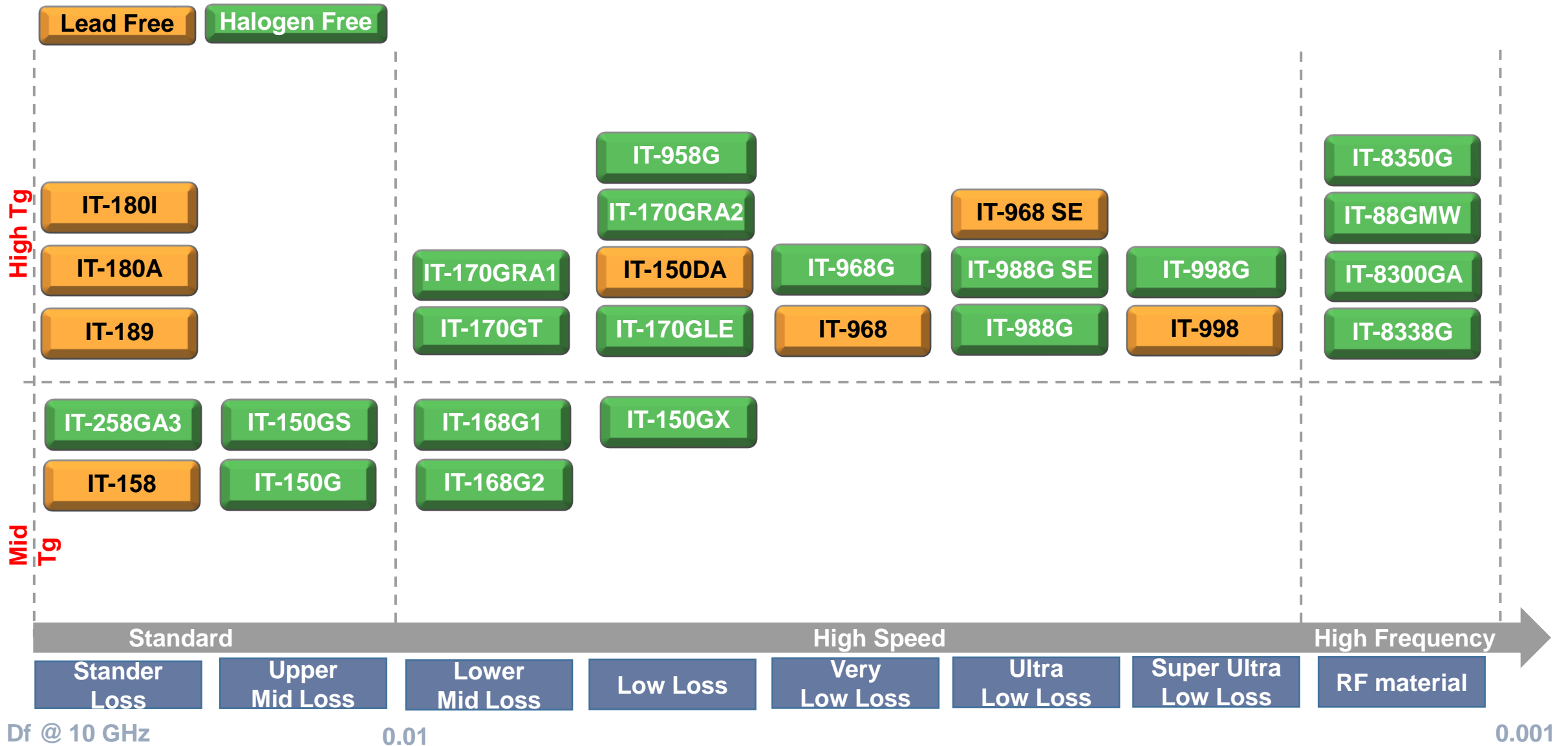
銅箔



PP 黏合

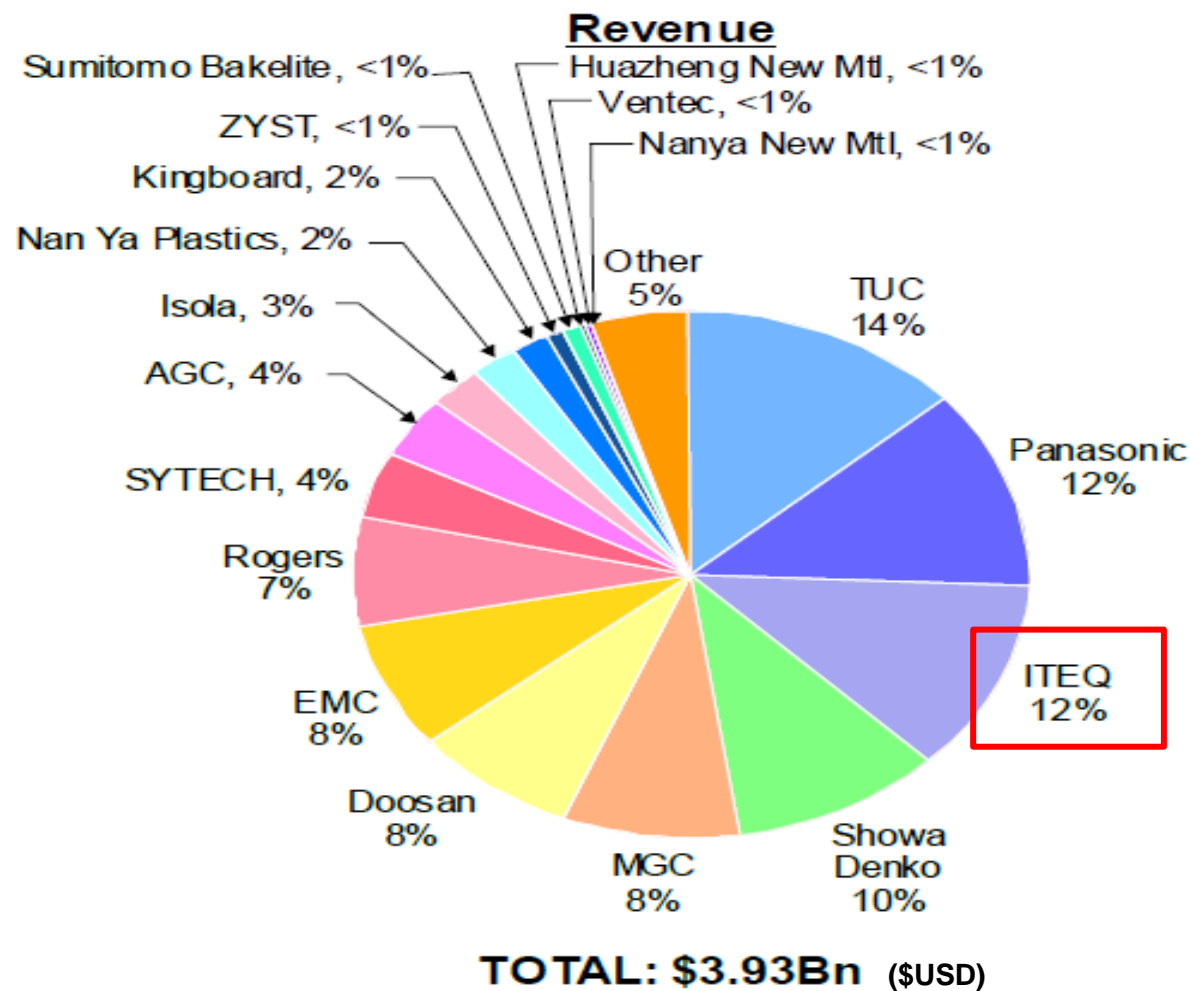








2020年特殊基板供應商市佔率



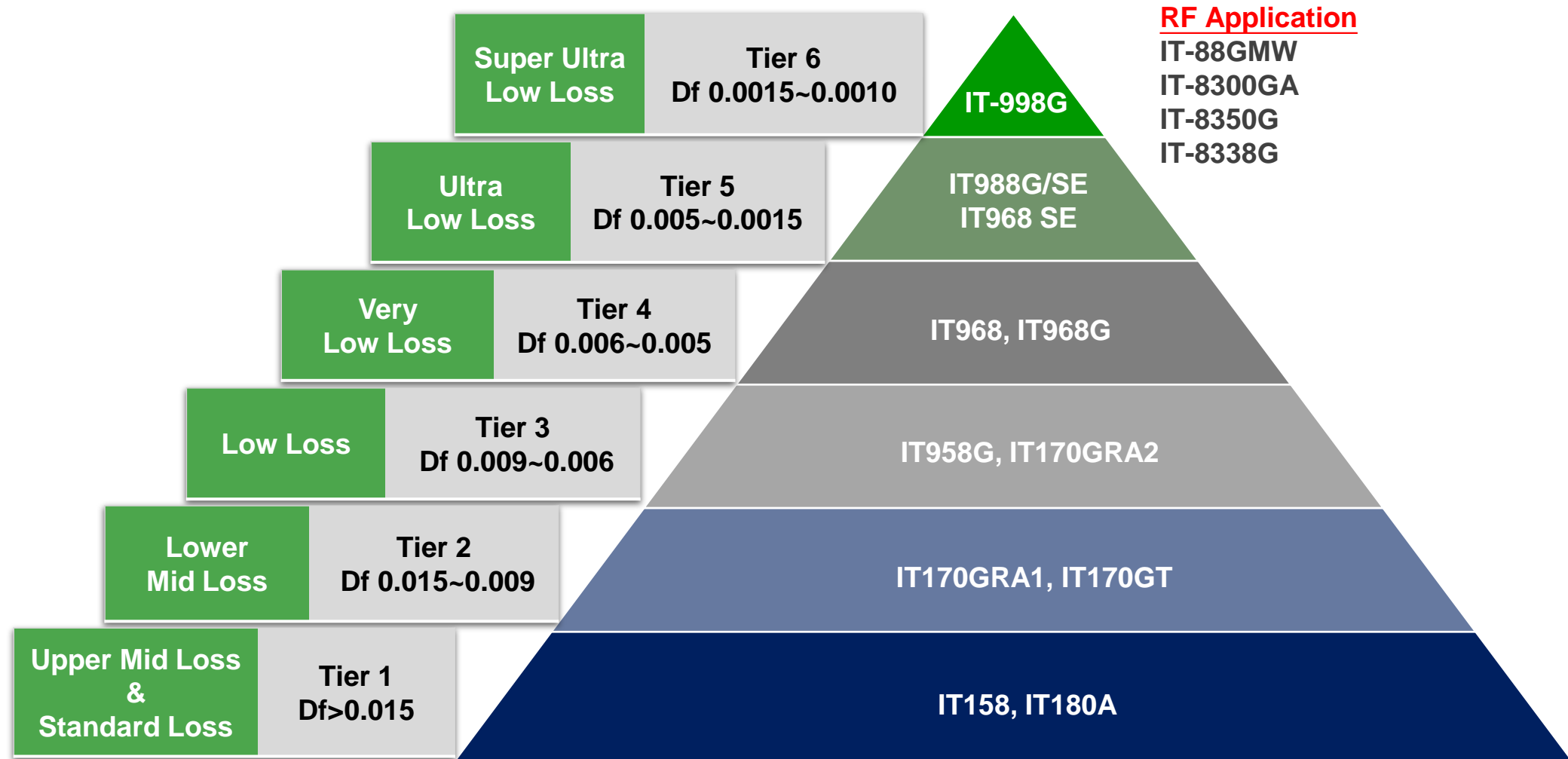
*特殊基板包含: 高速基板、封裝基板、射頻基板
資料來源: Prismark Report, 2021/06

聯茂: 銅箔基板領先供應商

- 全球高速高頻銅箔基板主要供應商
- 先進製程技術和豐富量產經驗
- 5G網路通訊與資料中心商機之長期受惠者
- 電動車市場崛起擴大車用電子對高速高頻材料需求



INNOVATION · TEAMWORK ·
EXCELLENCE · QUALITY

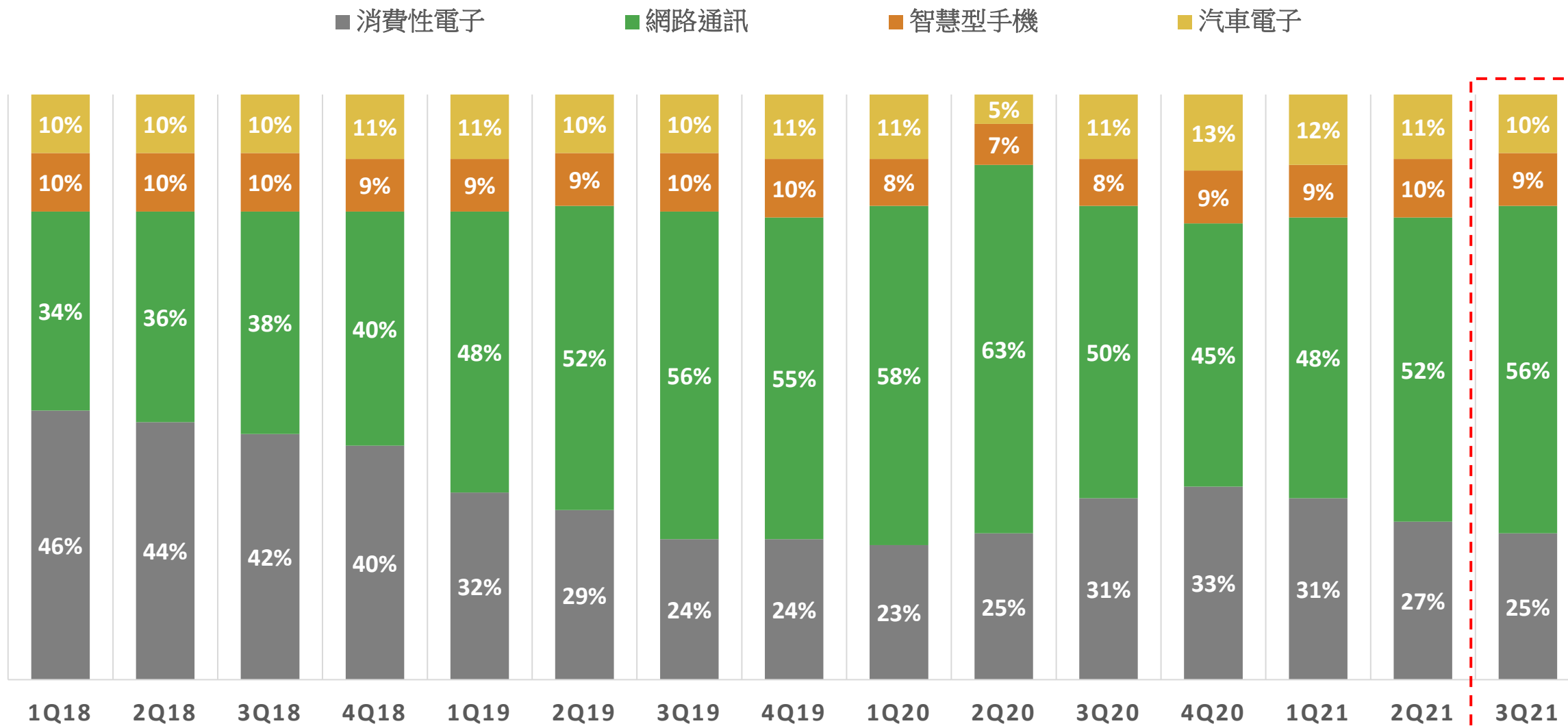


RF Application

IT-88GMW
IT-8300GA
IT-8350G
IT-8338G

- 隨著5G商用化、伺服器升級等需求，將帶動高頻高速材料需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。

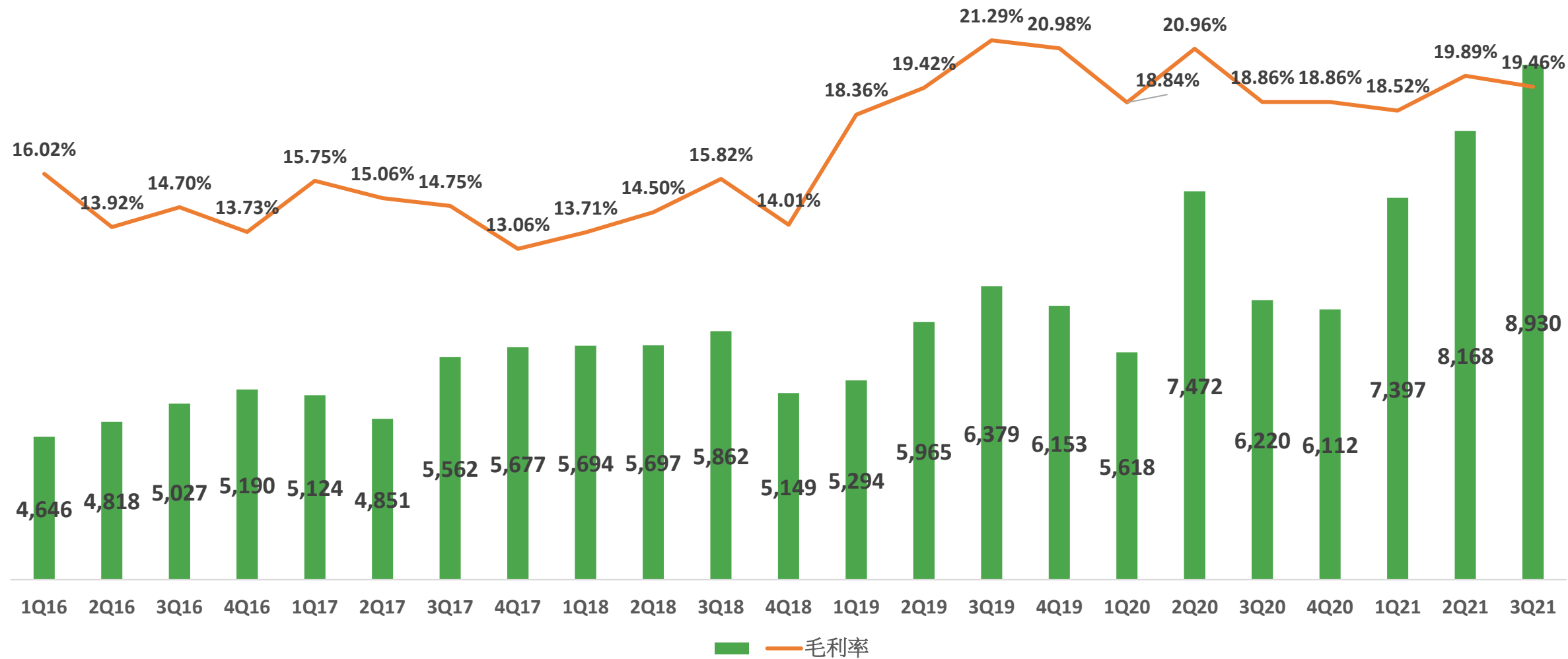
1Q18~3Q21產品組合



營收 & 毛利率

ITEQ

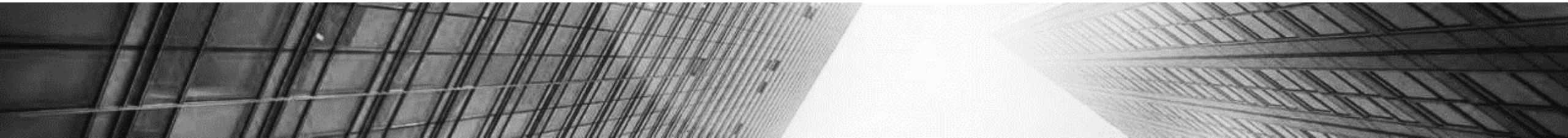
(百萬 NTD)



3Q21 損益表

NTD/百萬元	3Q21	2Q21	3Q20	QoQ	YoY
營業收入	8,930	8,168	6,220	9%	44%
營業毛利	1,738	1,625	1,173	7%	48%
營業費用	631	483	454	31%	39%
營業利益	1,107	1,142	719	-3%	54%
營業外收入及支出	(11)	(19)	97	-42%	-111%
稅前淨利	1,096	1,123	816	-2%	34%
所得稅費用	261	263	172	-1%	52%
歸屬於母公司之淨利	835	860	644	-3%	29%
每股盈餘(NTD)	2.40	2.58	1.94	-7%	24%
重要財務比率					
毛利率	19.46%	19.89%	18.86%		
營業費用率	7.07%	5.91%	7.30%		
營業利益率	12.40%	13.98%	11.56%		
有效稅率	23.81%	23.42%	21.08%		
淨利率	9.35%	10.53%	10.37%		

NTD/百萬元	3Q21	2Q21	3Q20
資產總額	36,035	32,698	25,953
現金及約當現金	4,035	2,749	3,625
短期投資	5	5	6
應收帳款/票據	14,100	13,403	11,200
存貨	5,194	4,161	3,330
固定資產/預付設備款	10,117	9,569	5,896
負債總額	15,681	17,960	13,527
短期借款	1,434	3,144	2,331
應付帳款/票據	8,432	7,661	6,328
長期借款	-	1,370	1,640
股東權益總額	20,354	14,738	12,426
重要財務指標			
應收帳款週轉天數	149	159	156
存貨週轉天數	66	64	56
應付帳款週轉天數	98	102	111
股東權益報酬率(年化)(%)	18.50	20.80	23.90
資產報酬率(%)	10.31	10.23	10.57
負債比(%)	43.50	54.93	52.12



市場趨勢 & 成長動能

ITEQ

● 全球資料領域加速擴增

- 核心 (傳統 / 雲端資料中心)
- 邊緣運算 (企業強化版基礎建設，如公司機房 & 廠內外伺服器、訊號發射站等等)
- 終端 (電腦、智慧型手機、IoT 裝置)

● 全球IP流量高速成長

- 超高畫質影音串流、線上遊戲下載執行
- 物聯網相關應用 (智慧家庭、遠端醫療與自駕車)
- 大數據分析與人工智慧(AI)
- 雲端運算與雲端儲存
- 虛擬實境(VR) 與擴增實境 (AR)



(Source: Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, May 2020)

- 全球資料流量大幅提升，帶動網路服務營運商及電信商升級設備來滿足低延遲、高可靠與高速運算處理需求

核心網絡升級、傳輸網絡升級:

- 包含 數據中心、邊緣運算、高速光傳輸
- 高性能計算、大容量高速

高速材料

基帶處理單元(DU+CU)

- 實現低訊號延遲, 高速傳輸處理
- 包含 宏基站 到 小基站

高速材料

射頻單元(AAU)

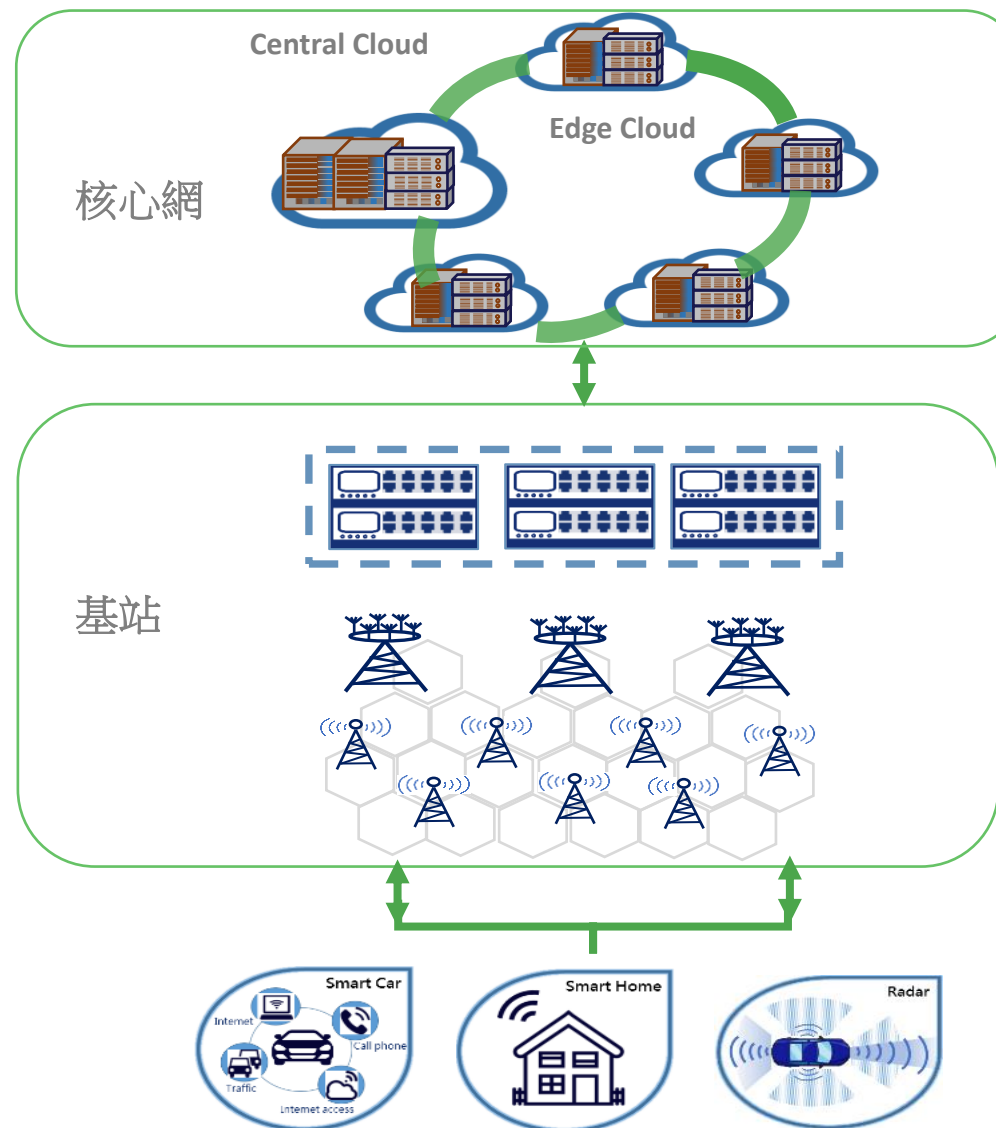
- 包含天線、功率放大器模組與射頻模組
- 高多層設計因應功能複雜化

高速材料

高頻材料

IOT(Internet of Things):

高速材料



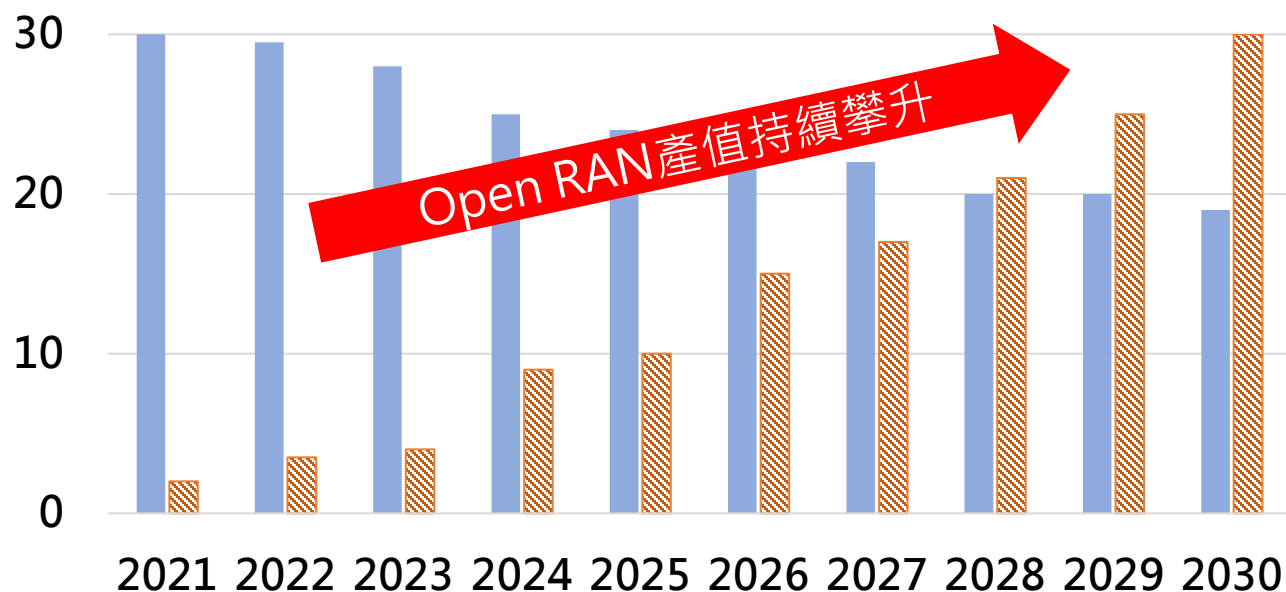
2021~2030年RAN設備營收預估

RAN為無線電接入網(Radio Access Network)

單位: 十億美元

■ 傳統RAN

■ Open RAN



資料來源: DIGITIMES Research, 2021/7

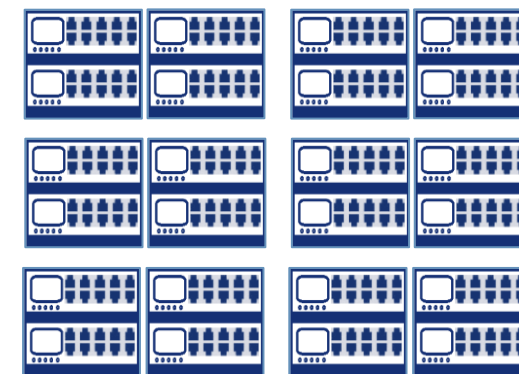
傳統RAN



+



Open RAN



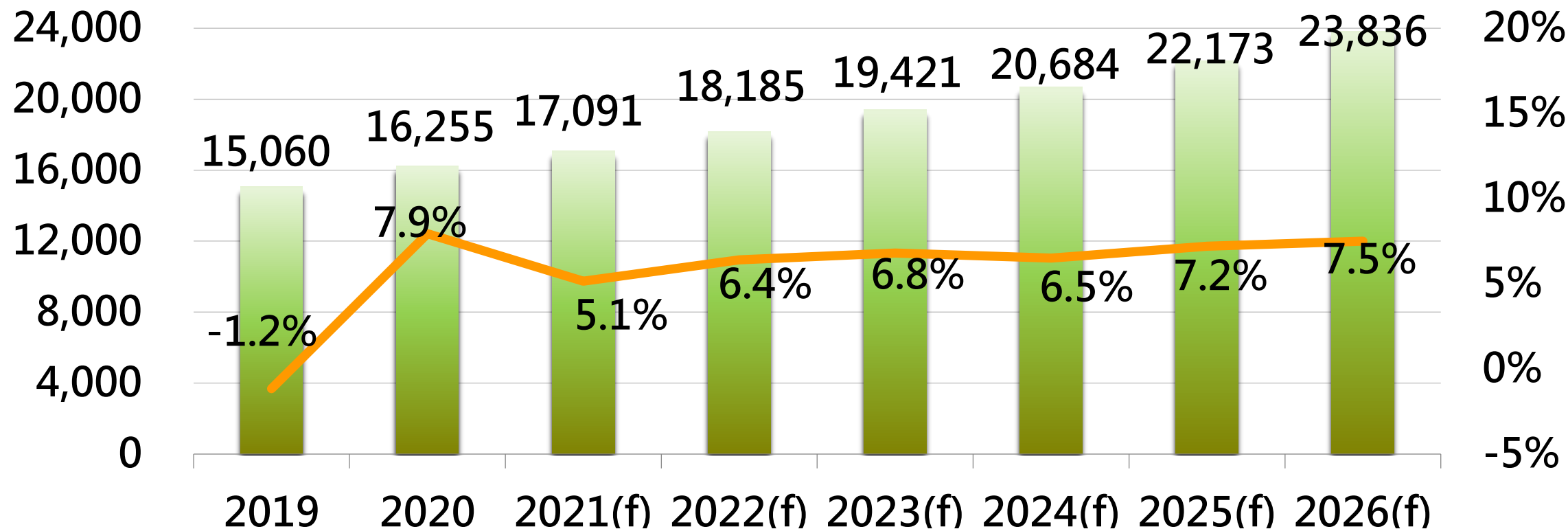
+



- 擴大中的Open RAN市場: 另一推動5G網通設備市場規模的主要動力
- 推動邊緣運算伺服器與白牌5G設備材料需求之潛在商機

2021~2026年全球伺服器出貨量CAGR估6.9%

單位：千台



資料來源：DIGITIMES Research · 2021/9

- 資料中心設備出貨成長：高速材料需求亦同步持續攀升

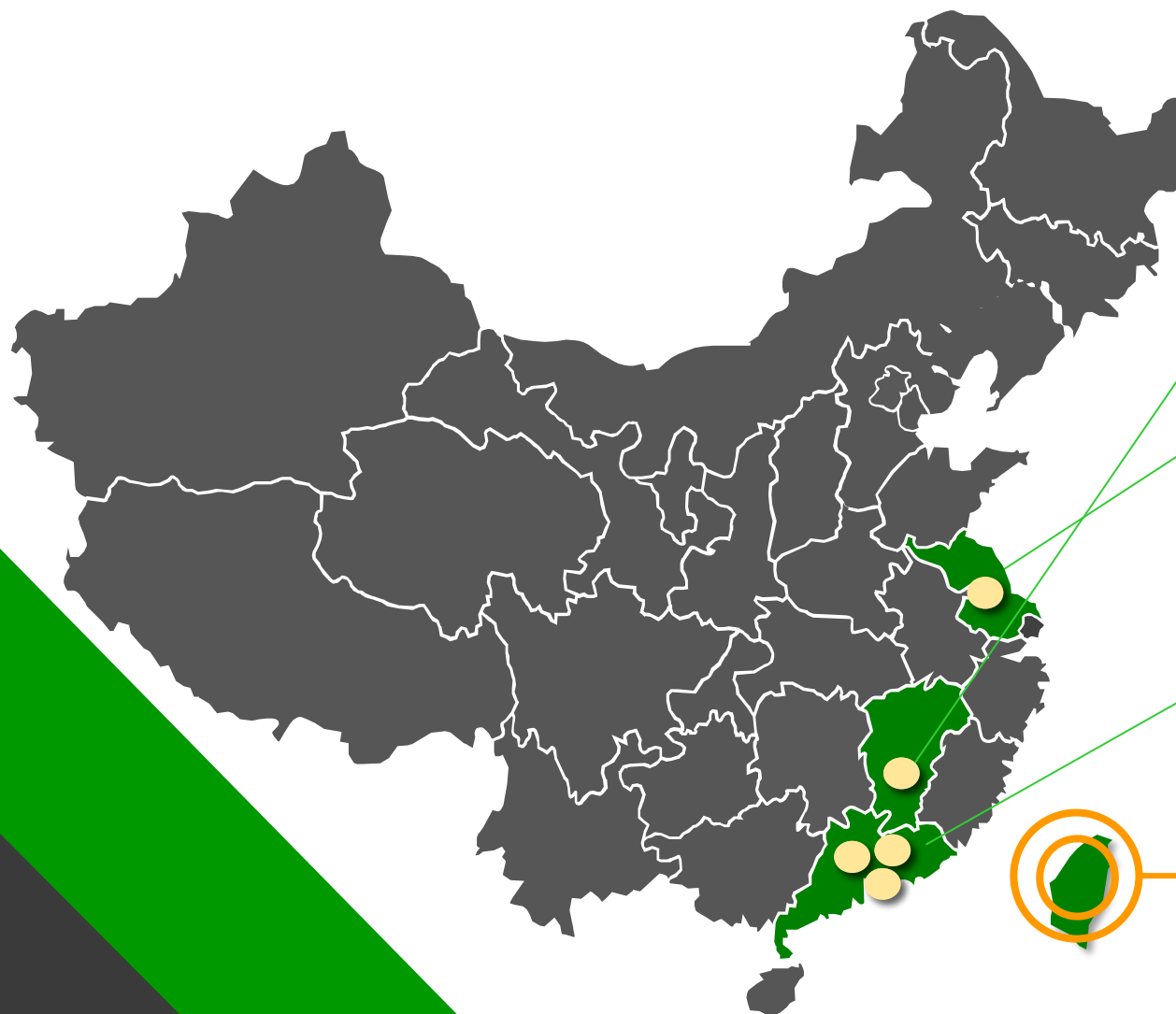
Intel	Platform	Purley		Whitley		Eagle Stream	
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Copper Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	14 nm++	10 nm	Intel 7	Intel 7
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	Cancel	2021 Q1	2022 Q2	2023 Q1
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Cancel	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	Cancel	12 to 16	16 to 20	16 to 20

AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)
	PCIe Generation	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q2
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20



資料中心長期穩定升級將有利予以下；

- 對應設備之基板材料亦同等升規
- 增加銅箔基板消耗量與設計板層數



江西廠

(第一期) - 2020

基板 (60萬 張/月)

膠片 (350萬 米/月)

(第二期) - 2021

基板 (60萬 張/月)

膠片 (350萬 米/月)

(第三期) - 2022 & 2023

基板 (120萬 張/月)

膠片 (500萬 米/月)



無錫廠

基板 (165萬 張/月)

膠片 (800萬 米/月)



東莞廠

基板 (100萬 張/月)

膠片 (400萬 米/月)



廣州廠

3L FCCL (75萬 平方米/月)

2L FCCL (14萬 平方米/月)



黃江廠

壓合代工 (50萬 平方呎/月)



台灣新埔廠 (總部)

基板 (35萬 張/月)

膠片 (180萬 米/月)

Distributor/Agent : USA 、 Europe 、 Israel 、 Korea 、 Japan 、 Singapore

2014 – 2020 配息政策

年度	每股盈餘(NT\$)	股利(NT\$)	現金股利(NT\$)	配息率(%)
2014	1.62	1.2	1.2	74%
2015	1.92	1.6	1.6	83%
2016	3.13	2.5	2.5	80%
2017	4.11	3.1	3.1	75%
2018	5.86	3.8	3.8	65%
2019	8.13	5.0	5.0	62%
2020	8.19	5.0	5.0	61%

*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股

**於2021年9月2日完成現金增資發行新股5千萬股；目前普通股數約為3.83億股



Thank you

Question and Comment